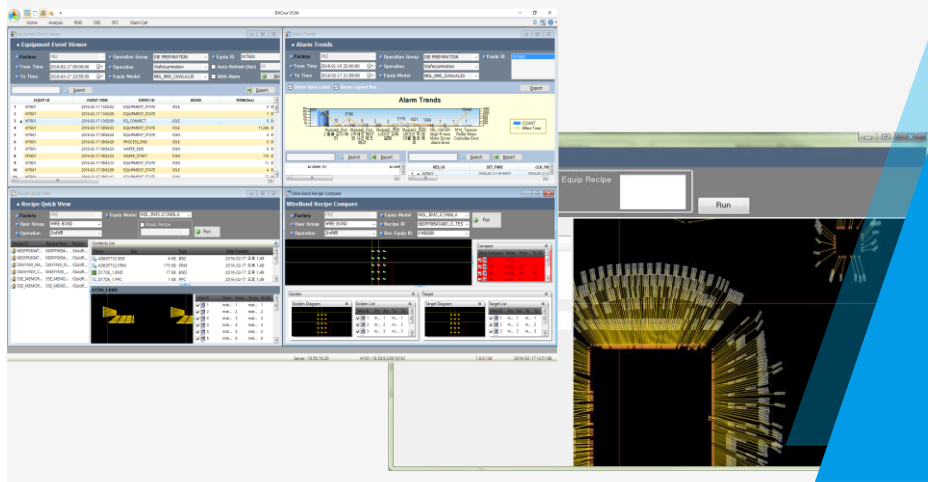


# Assembly 전체공정 RMS 구축 [특허적용]

Die Attach, Wire Bond, Background, Sawing, Mold, Assembly, Recipe Management System



## Project Description

- 고객 : 반도체 조립 위탁 생산 업체
- 솔루션 : Nexplant QMS(RMS)
- 범위 : Wafer 입고, BG, SAW, DA, WB, MOLD, SST, SBA, Assembly 전체 공정  
- 전체공정설비 RMS 및 자동화

## 01 The Challenge

- 공정별 다수의 동일설비에 대한 Recipe 배포, 관리 시스템 구축 요구 증가, Recipe 작업자 Manual 배정으로 신뢰성 저하
- 반도체 Assembly 공정 설비 표준 I/F인 SECS 준비 미흡
- MES 실적입력, 원부자재 관리현황 등의 수작업 의존
- 설비의 미세한 생산 이력, Alarm Event의 추적분석 미흡

## 02 The Solution

- 설비 Recipe Up/Down/Compare 자동화를 통한 생산 신뢰성 확보, Recipe 자동배정
- RMS 솔루션을 통한 안정적이고, 확장성 높은 EES시스템 구축
- 관리현황 자동집계 시스템 구축 및 프로세스 표준화를 통한 전공정 확산 체계 구축
- Nexplant QMS(RMS) 도입을 통한 공정, 품질 실시간 모니터링 대응체계 확립

## 03 Benefits

- 전공정 표준화된 RMS를 통한 생산품질 안전성 확보
- 전체 설비 SEMI 표준 I/F를 통한 제어, 관리, 데이터 수집이 가능
- MES 실적 자동 집계 및 생산제어, 원부자재 정합성 확보
- 설비이력 자동집계에 의한 실가동률 및 Alarm 분석 가능